

**特点:**

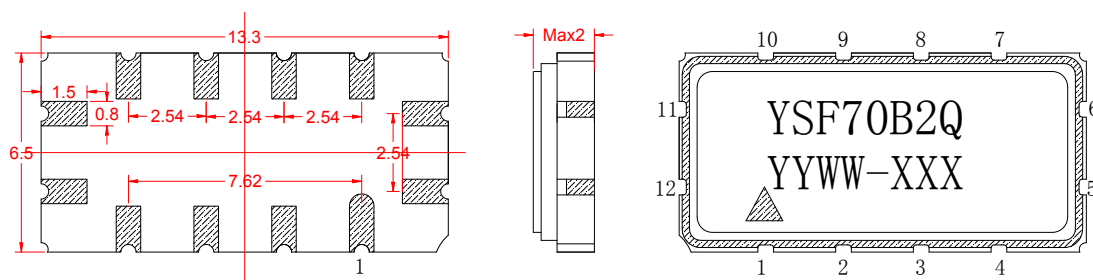
- 中心频率: 70MHz
- -1dB 带宽:  $\geq 1.6\text{MHz}$
- -40dB 带宽:  $\leq 4.5\text{MHz}$
- 带外抑制:  $\geq 40\text{dB}$
- SMT 封装
- 尺寸:  $13.3 \times 6.5 \times 2$  (max) mm

**图片:**

**性能参数: (50Ω系统,  $T_A = -55 \sim +85^\circ\text{C}$ )**

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
中心频率	$f_0$	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=70\text{MHz}$ , SPAN=10MHz		70		MHz	
-1dB 带宽	$BW_{-1dB}$		1.6	1.95		MHz	单边带宽 $\geq 800\text{KHz}$
-40dB 带宽	$BW_{-40dB}$				4.5	MHz	
插入损耗	IL	$f_{TEST}=70\text{MHz}$ , SPAN=1.6MHz		10	11	dB	
带内波动	BR		0.5	1	dB		
群时延波动	$\Delta \tau$		30	100	ns		
带外抑制		$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=70\text{MHz}$ , SPAN=100MHz	40			dB	
质量	m			1	2	g	

注: 声表滤波器输入输出端口测试阻抗为  $50\Omega$ 。

**外形尺寸图:**


注: 1、未标注公差按 GB/T1804-2000 规定, 公差等级 f;

- 2、产品本体采用氧化铝陶瓷金属封装, 引脚及底部焊盘表面镀镍金 (Ni 1.3~8.9um, Au0.3~5.7um);
- 3、产品标识采用激光刻字, 完成后盖板和底座进行平行缝焊处理。

**字符标志:**

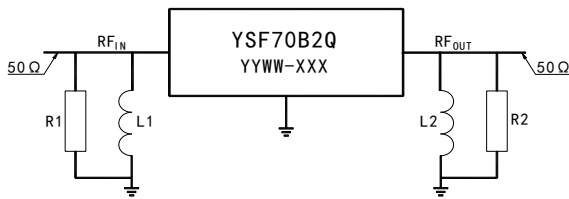
标识	说明	备注
YSF70B2Q	产品型号	
YYWW	批次号	
XXX	序列号	
▲	1脚&静电敏感标识	

**极限参数表:**

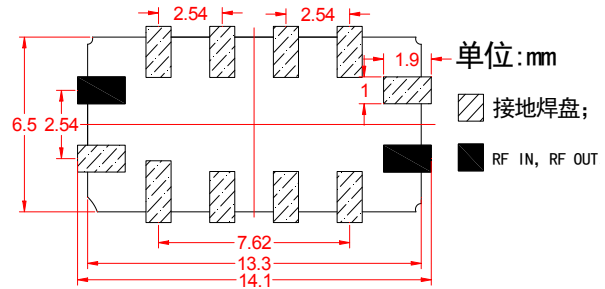
参数名称	极限值
输入射频功率	+10dBm
装配温度	230℃, 20s
工作温度	-55~+85℃
贮存温度	-55~+125℃

超过以上条件, 可能引起器件永久损坏。

### 推荐外围电路



### 推荐焊盘



### 推荐外围电路

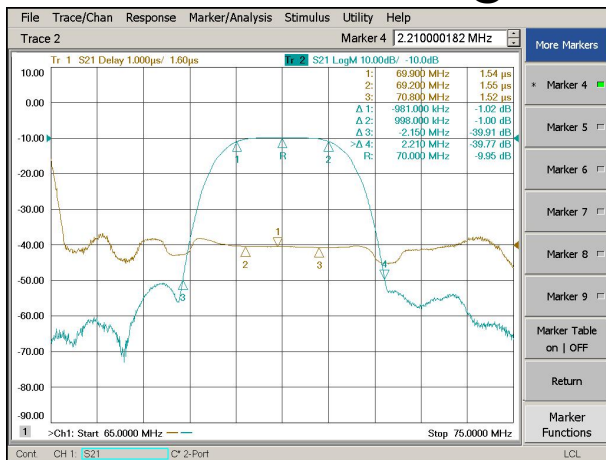
位号	感/容值
L1 L2	56nH,精度≤5%
R1 R2	200R,精度≤5%

### 引脚定义

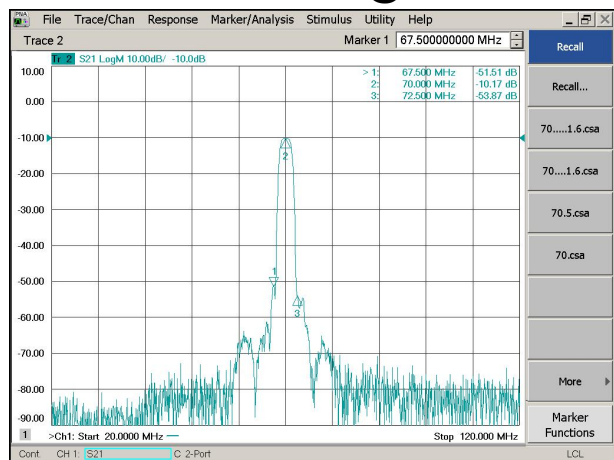
引脚编号	符号	描述
11	RF <sub>IN</sub>	输入
5	RF <sub>OUT</sub>	输出
1	▲	1脚及静电敏感标识
其他	GND	接地

### 典型测试曲线:

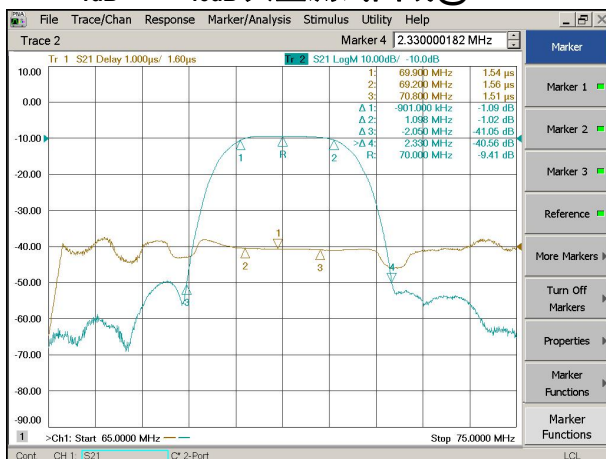
#### BW<sub>-1dB</sub>/BW<sub>-40dB</sub> 典型测试曲线@25°C



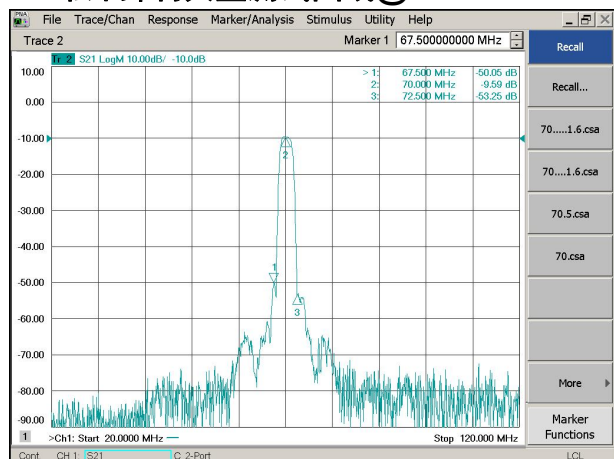
#### 带外抑制典型测试曲线@25°C



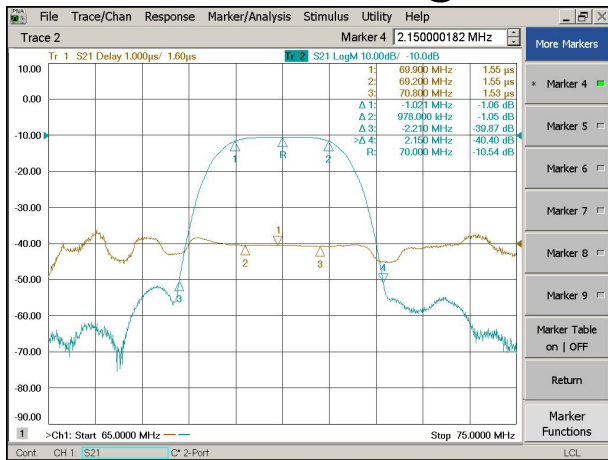
#### BW<sub>-1dB</sub>/BW<sub>-40dB</sub> 典型测试曲线@-55°C



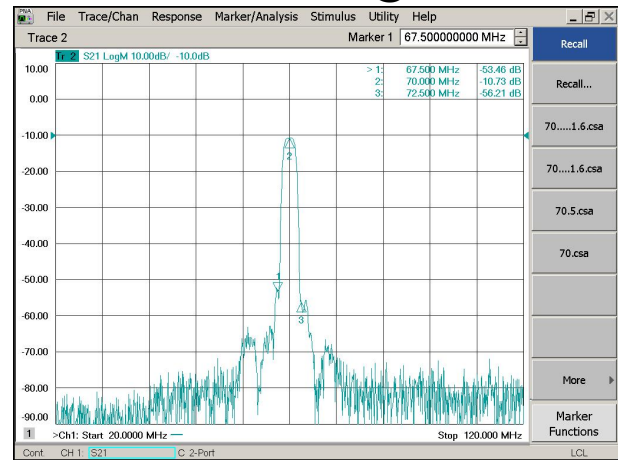
#### 带外抑制典型测试曲线@-55°C



## BW-1dB/BW-40dB 典型测试曲线@85℃

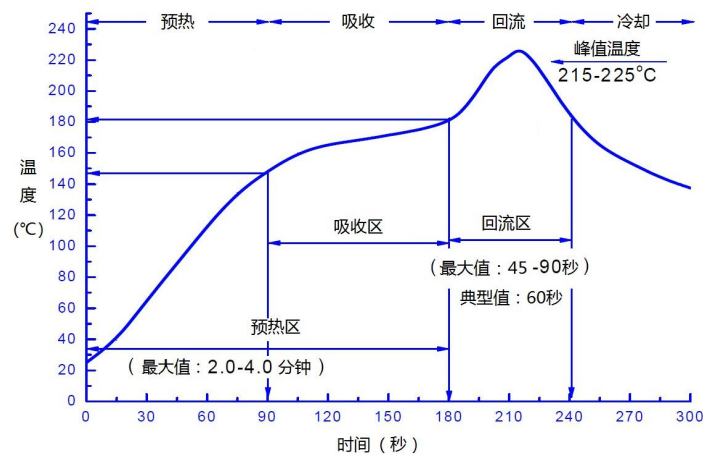


## 带外抑制典型测试曲线@85℃



### 产品使用注意事项:

1. 产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
2. 产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）；
3. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 230℃。

4. 如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。